

一般社団法人 半導体産業人協会  
理事長 吉澤六朗  
講演企画委員長 有門経敏

## 2026 年度 5 月度フォーラム開催案内

平素、半導体産業人協会の活動に格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。2026 年 5 月度フォーラムの開催案内をご案内いたします。今年から講演件数を 4 件以上に増やし、半導体のみならず半導体のアプリケーションも含めて幅広く情報を提供致しております。今年度第 2 回目は半導体市場動向からデバイス、データセンターを支えるハードディスクを取り上げました。それぞれに専門分野を詳しく解説して頂きます。また、講演件数の増加に伴い、従来無料であった会員（個人会員、準会員、賛助会員）の方々からも若干の参加費をいただくことに致しました。会員の皆様にはなにとぞご理解をお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 開催日時

2026 年 5 月 18 日 (月) 13:00~19:00

#### 2. 開催場所

林野会館 (+オンライン)

所在地：〒112-0012 東京都文京区大塚 3-28-7

最寄駅：地下鉄丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩 7 分

電話：03-3945-6871

#### 3. プログラム (講演時間には Q&A 10 分を含む)

13:00~14:00 (60 分) 『世界半導体市場の動向と日本のあるべき戦略』

Grossberg (同) 代表 大山聡氏

14:00~15:00 (60 分) 『MOS を基本にしたデバイスの面白さ、プロセスの面白さ、材料の面白さ』

東京大学名誉教授 鳥海明氏

15:00~15:10 (10 分) 休憩

15:10~16:10 (60 分) 『半導体のサーマルマネジメント最前線

— 空冷・液冷・液浸冷却の潮流とベーパーチャンバーの役割』

産業技術総合研究所 馬場宗明氏

16:10~17:10 (60 分) 『なぜハードディスクビジネスは生き残ったのか』

(株)レゾナック・ホールディングス CTO 福島正人氏

17:20~19:00 懇親会

#### 4. 講演内容

##### (1) 『世界半導体市場の動向と日本のあるべき戦略』

講師：Grossberg (同) 代表 大山聡氏

概要：世界半導体市場は年率 20%をはるかに上回る成長を続けているが、伸びているのは AI が必要とするロジックとメモリ分野に集中しており、日本勢が得意とする MCU やパワーデバイスは伸び悩んでいる。日本政府は半導体産業の再燃を目指して、TSMC を誘致したり、ラピダスを立ち上げたり、様々な政策を打ち出しているが、これに追随する民間企業からは熱意が感じられず、官民のギャップは開いたままである。この現状を踏まえた上で、世界の半導体市場は今後どのような成長を遂げるのか、そして日本の半導体戦略はどうあるべきなのか、について私見を述べてみたい。

##### 講師略歴：

慶應義塾大学 大学院管理工学にて修士課程を修了

1985 年 東京エレクトロン入社。

1996 年から 2004 年まで ABN アムロ証券、リーマンブラザーズ証券などで  
産業エレクトロニクス分野のアナリストを務めた後、富士通に転職、  
半導体部門の経営戦略に従事。

2010 年より IHS Markit で半導体をはじめとしたエレクトロニクス分野全般の  
調査・分析を担当

2017 年 9 月に同社を退社し、同年 10 月からコンサルティング会社 Grossberg  
合同会社に専任



##### (2) 『MOS を基本にしたデバイスの面白さ、プロセスの面白さ、材料の面白さ』

講師：東京大学名誉教授 鳥海明氏

概要：大学で半導体を研究してきたわけでもないのに、社会に出てから 17 年を東芝で、19 年を大学で半導体にかかわってきた。このフォーラムに参加されている日本の半導体産業を支えてきた方に対しては不謹慎かもしれないが、面白くないことにはあまり気合いがはいらないので記憶が曖昧である。というわけで今回は個人的に思っていたよりも面白かったことを紹介させて頂こうと思う (他の人にとってはあまり面白くないかもしれない)。Si MOSFET からの発光、2 次元から 3 次元へのトンネル、Ge の酸化/ショットキー界面の異常性、高誘電率 HfO<sub>2</sub> の制御と強誘電性、・・・など。役に立つとかロードマップとかは研究資金を得るために人並みに口にするが、そのベースにある面白さをみつけることが最重要であった。自分のような並みの研究者に一発逆転のでかい勝負をしろというのは所詮無理な話であるのだが、技術の面白さを尊重する風土を繋いでいくことは時々出てくる業界の大谷君を見逃さないためにも絶対に重要であると信じている。

講師略歴：

1983年 東芝総研入社  
1988年 (1.5年間) MIT  
2000年 東芝退職 → 東京大学大学院工学系研究科材料学専攻  
2001年 (7年間) 半導体 MIRAI プロジェクト High-k グループ (兼務)  
2019年 東京大学定年退職  
2019年 (半年間) Dresden 工科大学  
現在 自由人



参考文献 (応用物理学会誌)：

2023 功労会員随想：「全国のシニアな応物学会メンバーよ、決起せよ！」  
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/92/11/92\\_692/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/92/11/92_692/_pdf/-char/ja)  
2020 特別寄稿：「我がシリコン技術は永久に不滅です！」  
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/89/8/89\\_433/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/89/8/89_433/_pdf/-char/ja)  
2018 業績賞寄稿：「今日までそして明日から」  
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/87/7/87\\_482/\\_pdf/-char/ja](https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/87/7/87_482/_pdf/-char/ja)

### (3) 『半導体のサーマルマネジメント最前線 — 空冷・液冷・液浸冷却の潮流とベーパーチャンバーの役割』

講師：産業技術総合研究所 馬場宗明氏

概要：半導体の高集積化・高性能化に伴い、発熱量や発熱密度の増大が進み、ホットスポットの抑制は性能・信頼性・歩留まり、さらには消費電力や冷却コストにも直結するため、サーマルマネジメントはデバイス・パッケージから装置・システムまで横断的な重要課題となっています。本講演では、半導体のサーマルマネジメント技術の最新動向として、空冷、直接液冷、浸漬冷却を含めた冷却技術の潮流の全体像と、それぞれの適用領域やボトルネックを解説します。さらに、各方式に共通して効く「熱を広げる」要素技術としてベーパーチャンバーに焦点を当て、基本原理と温度均一化のメカニズム、さらに性能を支配する要因（ドライアウト、姿勢依存、熱抵抗）とそれを解決する最新の研究開発動向についてご紹介します。

講師略歴：

2013年 九州大学大学院 航空宇宙工学専攻 博士課程修了  
2013年 国立研究開発法人産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門  
(現在の省エネルギー技術研究部門) に入所  
現在に至るまで、半導体の冷却技術、固体酸化物型燃料電池の高効率化、排熱発電技術など、多様な熱マネジメント技術に関する研究開発に従事  
2025年 東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師  
専門は熱工学、微細加工、相変化伝熱、混相流、微小重力実験



#### (4) 『なぜハードディスクビジネスは生き残ったのか』

講師：(株)レゾナック・ホールディングス CTO 福島正人氏

概要：本講演では、「半導体メモリや SSD の台頭にもかかわらず、なぜハードディスク (HDD) ビジネスは生き残り続けているのか」という疑問を、技術史・市場構造・企業文化の三つの視点から解き明かす。HDD は 1956 年の誕生以来、記録密度を 1000 万倍以上向上させ、物理限界に挑み続けることでデータセンターを中心とした大容量ストレージの中核として進化してきた。その背景には磁気記録方式の革新、ナノレベルの精密設計、材料技術と量産技術を高度に融合させる日本主導の技術基盤がある。さらに、業界再編を勝ち抜いた企業に共通する徹底した顧客至上主義、スピードを最優先する意思決定、挑戦を許容する組織文化にも焦点を当てる。本講演を通じて、HDD の事例から成熟産業においても競争優位を持続させるための技術戦略と組織の在り方について考察する。

#### 講師略歴：

1991 年昭和電工 (現レゾナック・ホールディングス) に入社し、ハードディスク工場に配属。昭和電工エレクトロニクス (SEL) 研究開発センター リーダー、ハードディスク事業部 営業部長、デバイスソリューション事業部 営業部長 兼 生産技術統括副部長、デバイスソリューション事業部 技術開発統括部長 兼 SEL 研究開発センター長を歴任し、2023 年 1 月より株式会社レゾナック・ホールディングス 執行役員 CTO (最高技術責任者)。



#### 5. 参加費

今年からできるだけ多くの方に興味を持っていただけるように講演件数を 4 件以上に増やし、それに伴って、SSIS 会員 (個人会員・準会員・賛助会員) の聴講料を 2,000 円/人、DAFS 会員企業の社員の聴講料を 4,000 円/人、一般の方の聴講料を 8,000 円/人とさせていただきます。なにとぞご理解のほどをお願い申し上げます。なお、懇親会は 3,000 円/人に据え置きと致します。

- 会員・準会員・賛助会員：講演聴講：2,000 円/人、懇親会：3,000 円/人  
(注：70 歳以上の個人会員は聴講費無料)
- DAFS 会員企業の社員：講演聴講：4,000 円/人、懇親会：3,000 円/人
- 一般：講演聴講：8,000 円/人、懇親会：3,000 円/人

#### 6. 申し込み方法

- ・ 申し込み締め切り：2026 年 4 月 28 日 (水) 17:00
- ・ 申し込み先：[info@ssis.or.jp](mailto:info@ssis.or.jp)
- ・ 本メールに返信の形で事務局 ([info@ssis.or.jp](mailto:info@ssis.or.jp)) まで申し込みください。

【氏名】 \_\_\_\_\_ 【ご所属】 \_\_\_\_\_

(注) お申込者の氏名、所属については請求書、領収書の発行時の宛先となりますので、ご了承ください。

【領収書】

領収書を希望する  領収書は不要

【SSIS 会員、DAFS 会員、一般】

SSIS 会員、  DAFS 会員【会社名： \_\_\_\_\_ ）、  一般

【フォーラム】

林野会館で参加  リモートで参加

【懇親会】

参加  不参加

7. 請求書・領収書について

- ・ 申し込み頂きましたら、SSIS の銀行口座を記載した請求書をお送りいたしますので、申込んだ方（SSIS 会員、DAFS 会員、一般の方とも）はフォーラム参加費と懇親会参加費（懇親会参加希望者）をお振り込みください。
  - ・ 請求書の宛先は、上記 6 項でご入力いただいたご氏名、ご所属となります。
  - ・ ご入金を確認されましたら希望者には領収書を発行いたします。上記 6.【領収書】の項目にチェックを入れてください。宛先は請求書と同じになります。なお、領収書の再発行はできかねますのでご了承願います。
- また、但し書きは『**SSIS 2026 年度第 2 回フォーラム聴講費及び懇親会参加費**』となります。  
懇親会に参加されない方につきましては『**2026 年度 SSIS 第 2 回フォーラム聴講費**』となります。  
但し書きにつきまして、**ご指定がございましたら下記にご記入ください。**

但し書き： \_\_\_\_\_

8. その他

- ・ オンラインで参加を希望される方には、開催 1 週間前をめどに、フォーラム参加費の振り込みを確認の上、オンライン接続情報（Zoom）をお送りします。
- ・ お申し込みをキャンセルされる場合は、申込期限までをお願い致します。期限を過ぎた場合には、返金致しかねますのでご理解、ご了承をお願い致します。
- ・ ご質問がある場合は、事務局 ([info@ssis.or.jp](mailto:info@ssis.or.jp)) までお問い合わせください。

\*\*\*\*\*

一般社団法人 半導体産業人協会

<https://www.ssis.or.jp>

TEL：03-6457-3245

FAX：03-6457-3246

\*\*\*\*\*